论文征集

第十七届上海国际 SMT 高层会议
无铅生产会议及专题讨论会论文征集
时间：2007 年 4 月 24-26 日
地点：中国，上海

主办单位： 中国信息产业部
承办单位： CCPIT 电子信息产业分会及 IPC
协办单位： BJSMT 和 CBC
研讨会日期： 2007 年 4 月 24-25 日
专题会议日期：2007 年 4 月 26 日
地点：上海光大会展国际大酒店 2 楼 10 号会议室

CCPIT、IPC、北京 SMT 和 CBI 将于 2007 年 4 月 24-26 日于中国上海 NEPCON 展会期间联合举办第 17 届上海国际 SMT 高层研讨会。

当前的无铅变革对全球经济带来了重大影响，也推动所有供应商和生产制造商纷纷按规定的过渡计划要求行动以消除铅的危害。就连不受其直接影响的设备生产商，如航空制造，也开始对此项变革对供应链和客户要求方面带来的影响开始进行评估。

作为一项全球持续执行的法规，企业在将重点放在制造技术的同时，也有长期可靠性方面的担忧。

演示文稿 / 论文提交

欢迎环保经理和技术专家就以下相关主题提供演示文稿 或论文：

- 欧洲/中国及其他地区关于有害材料和回收利用的相关立法
- 法则执行、政策实施以及产品销售
- 关于其它地区自愿执行法则的情况介绍（美国、中国、欧洲等等）
- 企业以及科研团体的项目及结果
- 设计相关问题（便利生产与拆卸的问题）
- PCB 相关问题 (无铅工艺的温度、PCB 表面等影响)
- 元器件问题 (无铅工艺的温度、BGA's 、老化报废等影响)
- 新型表面处理 (电镀技术，可焊性与锡晶须)
- 焊料合金比较(主流组如：SnAgCu, SnCu) 与专用组（如 SnZnAl)
- 替代方式（导电粘合剂）
- 无铅工艺（实施方法、工艺考虑和检测等实例）
- 修理与返工 (工艺控制、混合合金系统等)
- 可靠性评估 (研究、产品测试与在线测试、包括新测试方法)
- 汽车、航空等领域的无铅应用
- 环境保护与研究（材料的可利用性、毒性问题）
- 循环回收利用 (实例、计划与关注问题)
- 商业方面的问题 (供应链、成本-效益分析等)

会议提供 30-45 分钟时间陈述论文和进行讨论。陈述最好采用中文。演示文稿可采用英文或中英文化对照。

请随附表一并提交 200-300 字论文摘要及个人简历。论文摘要提交截止日期为 2007 年 3 月 15 日。论文正文需在 2005 年 3 月 28 日前提交。

要求提交的论文及相关资料为非商业性质，集中讨论技术方面问题而非公司产品介绍。
务请提供可用于印刷会刊或会议投影之用的电子文档。

会议发言者可享受打折入场券、一份会刊以及所有饮料。

赞助和参加会议
有意赞助和参加会议企业，请联系 **Sally Cai +86 21 5497 3435 , scai@ipc.org** 。

注册信息
如果企业愿意收到有关此会注册信息， 有关详情请登陆 IPCShanghai@ipc.org 查询

专题演讲申请

第十七届上海国际 SMT 高层会议
无铅生产会议及专题讨论会论文征集
时间：2007 年 4 月 24-26 日
地点：中国，上海

请填写下列表格并将个人简介和演讲摘要一并传真或发电子邮件给 **David W. Bergman, CAE**
Vice President Standards, Technology and International Relations,
IPC
3000 Lakeside Drive #309S
Bannockburn, IL 60015-1249
Dir. Line +1 847-597-2840 or +86 21 5497 3435
Dir. Fax +1 847-615-5640
E-mail IPCShanghai@ipc.org or web www.ipc.org/IPCShanghai

Specific conference questions, please e-mail David Bergman at DavidBergman@ipc.org

姓名 Name

公司 Company

职务 Title

地址 Street Address

城市 City

邮编 Post/Zip Code

国家 Country

电话 Phone

传真 Fax

E-mail

请有意在大会上作演讲的人士，随表另附 200-300 字的演讲摘要以及一小段个人简历，一并传真或 email 到上述地址。

论文题目:

该论文以前是否发表或提交过?
(　　)Yes,　　(　　)No

如果是，何时？何地？

论文摘要提交截止日期为 2007 年 3 月 15 日。
论文正文需于 2007 年 4 月 9 日前提交.